

**株式会社東京精密 2022年度(2023年3月期) 第1四半期 決算説明会**  
**質疑応答 要約**

2022年8月2日 開催

1. 本資料は、上記日時に開催された2022年度(2023年3月期) 第1四半期決算説明会(Web開催)の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
2. 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
3. なお、本資料では、半導体製造装置(または同セグメント)を「SPE」、精密計測機器(同左)を「計測」と表記します。

**1. 両製品事業の1Q 製品別 受注高・売上高構成を頂きたい。**

- SPEの受注高構成は検査装置(プローバ)60%前半、加工装置(ダイサ、研削装置)が30%後半(ダイサ < 研削装置)。売上高は検査装置60%半ば、加工装置が30%半ばとなった。
- 計測の受注高構成は、汎用計測製品(三次元座標測定機等)が約60%、センサ・充放電システムが40%。売上高は汎用計測60%前半、センサ・充放電システムが30%後半であった。

**2. 中国でのロックダウンによる1QSPE業績の未達規模、前年4Qにも発生した期ズレとの関係性を伺いたい。**

- 1QSPE業績の未達要因のほぼ全てが中国ロックダウンによるもの。売上で数十億円、営業利益で2ケタ億円の影響と見積もっている。
- 前年4Qもロックダウンによる期ズレが見られた。当1Qにこの売上が計上された一方で、新たな期ズレが発生した。

**3. 足許で受注済案件のキャンセルや納入延期要請は見られるか。業界・アプリケーション別の特徴はあるか。また、この動きは1Qの損益に影響したのか。**

- 受注済案件のキャンセルの要請は無いが、納入延期の話はある。
- 但し一方で、前倒しを要請される顧客もいる。納入延期要請は、概ねOSATからが多く、前倒しは個別の顧客単位で強弱があるように見られる。

- 係る状況で、当社は生産スロットをやりとりして対応している。
  - なお、これらは今後の売上案件に係る話であり、1Q実績とは連動しない。
4. 1Q計測受注高を押し上げた一時的要因の詳細、業績予想との関連をききたい。
- 一部計測製品について販売価格の改定(数%)をお客様に通知し、価格改定前に受注が集中した。当社の1Q受注高想定は100億円未満の水準であったが、上振れの多くがこの集中によるもの。
  - 5月説明会でコメントした通り、価格改定は2022年度業績予想に織り込んでおり、特に4Q以降収益に反映されると想定。
5. 1QのSPE営業利益率はロックダウンによる売上延伸があるも一定水準を維持したと理解したが、会社の評価はどうか?
- 前年4Qの営業利益率が高水準であったことや、部材価格の高騰を踏まえると、やや低下したとの理解でいる。
6. 1Qの計測営業利益率がやや物足りない水準であり、会社は製品ミックスを理由としたが、この詳細と、今後の方向感について伺いたい。
- 1Qは、ロックダウンの影響で、一部の高収益製品や、関連する構成部品などの当社への納入が遅れたことで製品ミックスが若干変化した。
  - これらは今後売上計上されるため、利益率は改善の方向に向かうと考える。
7. 1QのSPE消耗品販売実績について伺いたい。
- 前年度実績の四半期平均並みで着地。ダイシングブレードと研削装置消耗品がほぼ同水準。民生需要の減少でやや伸び悩んだ。
  - 当社の中期経営目標では、研削装置消耗品も含め、伸ばしてゆく所存である。
8. 現在の製品納期について伺いたい。
- 5月時点から大きな変化は無く、プローバは、12インチ用で約10か月、8インチ用で12か月。ダイサは5か月、研削装置は12か月超となっている。
9. 現在の部材調達状況について伺いたい。
- 5月時点から大きな変化はなく、厳しい状況が続いている。状況は、SPE・計測で大きく変わらない。
10. 2022年度業績予想を据え置いている。これを踏まえると2QのSPE売上高は、1Qからの挽回を想定し300億円後半となるが、この点は大丈夫か。またその場合、生産

稼働率はどうなるのか。

- 当社は売上計上に設置基準を採用しているため、顧客サイトでの立上に係るエンジニアの工数には注意を払わなければならない。挽回の確度は高いと考えているが、余裕がある状態ではない。
- また、生産稼働率は1Q・2Qで大きく変わらないと考える。

11. SPE の上期業績予想について、想定製品構成比の変更はないか。

- 変更はない。

12. 計測の2Q受注見通しについて、会社は、一時的要因からの反動減があるも高水準を想定している。その根拠や、足許の需要動向についてコメントを頂きたい。

- 2022年度に入り、日系モノづくり企業全般に、投資意欲の改善がみられている。半期単位で見ると、当社計測の受注の回復は明確になってきている。
- 自動車業界向けの回復は緩やかな状態が続いている一方、機械部品や半導体製造装置向けなどの需要が増えている感覚を持っている。
- 2Qの反動減と、こうしたベースの底上げが打ち消しあうので、水準を正確に読むことは難しい。

13. 足許 民生用途向け SPE 需要が弱いとされる。当社の SPE 受注に占める民生用とはどの程度か。また、2Q の SPE 受注想定に関してリスクは無いのか。

- SPE 受注に占める民生用途を特定するのは困難であり、定量的な回答は難しい。
- ただし、スマートフォンが需要をけん引していた数年前と比較すると、デバイスの用途が広まりを見せる他、当社研削装置などでは長期的な視点での発注も多い。
- こういった状況から、現時点では、民生需要の更なる減少が足許の SPE 需要にさらなる下押しとなる状況ではないと判断している。

14. 2Q の SPE 受注見通しにおける製品構成の変化と、2022 年度下期に向けた受注の方向感についてコメントを頂きたい。

- 2Q の製品構成比の大きな変化は想定していない。
- SPE 全般の長納期化に伴い、顧客は長期視点で装置を発注している。当社は、従前より、顧客サイドのビジビリティの変化により、一時的な SPE 需要の調整があると想定していた。
- また足許では、マクロ環境を踏まえた SPE の需要の不透明さがみられる。
- 一方で、長期視点では、半導体市場が成長してゆくことは間違いない。
- これらを勘案し、当社では、2022 年度中は緩やかな減少、2023 年度、とくに後半から大きく回復するベースシナリオを作成し、議論に用いている。

**15. 当社の SPE 受注・売上におけるパワー半導体向けの構成比を伺いたい。**

- 受注ベースでは、パワー半導体で1桁%後半、これに、基板関連の用途を加算するとおそらく10%前半程度になっていると考える。
- 売上ベースではまだそこまでいっていないが、前述の基板用途の売上が順次計上され、現在の受注ベースの比率に近づいてゆくと想定する。

**16. 化合物半導体向けの研削装置について、市場規模、競争環境、長期的な成長の可能性を伺いたい。**

- 当社に限って言えば、研削装置の成長幅は他製品より大きい。
- 市場規模・シェアについて正確に分析することは難しいが、難削材グラインダ(HRG)を含め、化合物半導体の加工に適する研削装置は多く、ポテンシャルは非常に高いと考えている。

**17. ウェーハ製造用の研削装置について、競争環境を伺いたい。**

- ウェーハ製造用では2-3年先の商談もあり、かなり強い引合がある。この分野に関しては長納期が競争環境の変化につながることは無いと考える。

以上